

证券代码：605358

证券简称：立昂微

杭州立昂微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-010

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 其他
时间	<p>2025年12月15日15:00-16:00 中信证券、国联民生证券、东北证券、财通证券、农银汇理基金、鹏扬基金、博时基金、泰康资产、混沌资产、翊安基金、复胜资产、巨子投资、同巨投资、优益增投资、长江资管；</p> <p>2025年12月16日14:30-16:00 中信证券、中信保诚基金、敦和资产、同盈资本、鑫鼎基金、盘京投资、金九瑞和、贵和、博信家办。</p>
上市公司接待人员姓名	董事长：王敏文 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：吴能云
投资者关系活动记录	<p>董事长王敏文、董事会秘书吴能云就公司的发展历程、主营业务、竞争优势、产业应用、未来发展规划等向与会投资者做了详细的介绍。</p> <p>公司投资者交流的问题回复内容如下：</p> <p>1.12英寸重掺硅片稼动率如何？</p> <p>答：12英寸重掺系列外延片满足高端功率器件需求，终端应用于AI服务器不间断电源、储能变流器、充电桩、工业电子、伺服驱动器、以及消费类电子、汽车电子、家用电器、嵌入式系统和工业控制等领域，市场需求广阔。现有12英寸重掺系列硅片产能爬坡迅速，目前稼动率约80%。</p> <p>2.公司12英寸硅片有存储芯片客户么？</p> <p>答：公司12英寸硅片已覆盖14nm以上技术节点逻辑电路和存储电路，以及客户所需技术节点的图像传感器件和功率器件，已进入部分存储芯片客户供应链。</p> <p>3.随着国产大硅片的扩产，公司是否面临价格竞争？</p> <p>答：公司的12英寸硅片产品包括重掺外延片和轻掺抛光片。公司的重掺硅片占国内市场份额超过30%，低电阻率重掺系列产品工艺等技术可保持全球同步领先，可参与全球竞争，随着低电阻率的重掺大尺寸硅片产品出货量增加，自第一季度以来硅片平均出</p>

货价格环比逐季提升。公司的轻掺抛光片产品系列将注重发挥公司外延技术特长，发展BCD轻掺硼硅片、CIS轻掺硼硅片等重点产品，着力研发先进制程用轻掺硅片，更加注重产品的技术实力、质量标准，公司不主动参与价格战。

4.公司化合物半导体射频芯片是代工模式么？

答：立昂东芯是一家专注于化合物半导体射频及光电芯片的代工制造平台，为客户提供晶圆代工和流片服务，开发了应用于多种产品的多项关键核心技术，拥有行业领先的制造工艺技术优势，产品主要包括四大类：（1）HBT芯片，已进入国产手机射频芯片供应链，实现核心客户全覆盖；（2）pHEMT芯片，已进入航空航天、低轨卫星领域并实现大规模出货；（3）VCSEL芯片，已成功切入高阶智能辅助驾驶与机器人核心供应链并实现大规模出货；（4）碳化硅基氮化镓芯片，目前已完成开发。